

2024 年 04 月 21 日

电子

SDIC

行业周报

证券研究报告

## ASML 中国大陆收入增长显著，台积电指引 AI 需求强劲

ASML 24Q1 新增订单不及预期，中国大陆收入占比大幅提升：

4 月 17 日，ASML 发布 24Q1 财报，实现收入 52.9 亿欧元 (YoY-21.6%，QoQ-26.9%)，毛利率 51.0%，同环比持平。系统销售收入下降至 39.7 亿欧元 (YoY-25.8%，QoQ-30.2%)，共售出 70 台光刻机 (EUV 11 台)，主要由于非中国区客户对光刻机需求放缓，而中国大陆地区收入达到 19 亿欧元 (YoY+41%，QoQ-14%)，收入占比提升至 49% (QoQ+10pct)，反映了中国半导体市场对于光刻设备的强劲需求，以及中国市场在全球半导体产业链中日益重要的角色。公司一季度新增订单为 36.1 亿欧元，远低于路透社分析师调查预期的 54 亿欧元。公司指引 24Q2 收入 57-62 亿欧元，毛利率 50%-51%，预计全年收入将与 2023 年基本持平，2025 年有望强劲增长。国内晶圆厂仍保持相对高水平的资本投入，这将拉动光刻机以及其他配套半导体设备的需求。4 月 12 日，国内半导体设备龙头北方华创发布一季度业绩预告，预计收入及归母净利润同比将高速增长，按指引中值测算净利率为 19.2%，同比提高 3.2pct，盈利能力持续提高。根据 SEMI 数据，由于内存市场复苏以及对高效能运算和汽车应用的强劲需求，全球用于前端设施的 300mm 晶圆厂设备支出预估在 2025 年首次突破 1000 亿美元，到 2027 年将达到 1370 亿美元的历史新高。从国内来看，中国大陆是全球最大的半导体设备市场，2023 年预计市场规模可达 366 亿美元，同比增长 29%。目前，国内半导体设备大部分依然需要依赖海外，未来随着半导体设备需求回升，叠加国产替代的持续推进，国内半导体设备公司有望深度受益。

台积电 24Q1 收入略超指引，AI 相关需求强劲：

4 月 18 日，台积电发布 24Q1 财报，实现收入 188.7 亿美元 (YoY+12.9%，QoQ-3.8%)，略超指引 (180-188 亿美元) 上限；毛利率 53.1% (YoY-3.2pct，QoQ+0.1pct)，位于指引 (52%-54%) 中值。从下游需求来看，AI 相关需求强劲，手机及 PC 缓慢复苏，IoT 及消费电子需求仍低迷，汽车去库存需求放缓。AI 将成为拉动公司 HPC (高性能计算) 需求增长的最强驱动力，24Q1 HPC 收入占比达到 46% (QoQ+3pct)，收入同比增长 21%，环比增长 3%。公司预计 2024 年 AI 服务器处理器收入将至少翻倍增长，收入占比超 10%，未来五年将以 50% 的年复合增速快速增长，2028 年收入占比超 20%。公司下调了 2024 年半导体行业 (不含存储) 增速至 10% (此前预计超 10%) 及晶圆代工行业增速至 15-20% (此前预计 20%)。公司对下一季度给出了积极指引，预计 24Q2 收入 196-204 亿美元，同环比均有所增长；毛利率 51%-53%，

投资评级 **领先大市-A**  
维持评级

首选股票 目标价 (元) 评级

行业表现



资料来源：Wind 资讯

升幅%	1M	3M	12M
相对收益	-10.3	-13.1	-12.3
绝对收益	-11.4	-4.8	-26.5

马良 分析师

SAC 执业证书编号：S1450518060001

maliang2@essence.com.cn

相关报告

AI PC 新品迭出，华为 P70 发布在即	2024-04-14
地震影响逐步明朗，三星 SSD 涨价超预期	2024-04-07
小米 SU7 大定超预期，半导体设备零部件国产化迫在眉睫	2024-03-31
铜缆助力 GB200 NVL72 高速互连，存储与面板景气度持续提升	2024-03-24
英伟达 GTC/SEMICON China 召开在即，AI/半导体国产化大有可为	2024-03-17

受地震导致的电价上涨影响；全年收入预计增长 20%以上，资本支出维持 280-320 亿美元指引。

#### 目 电子本周涨幅-2.59% (21/31) ， 10 年 PE 百分位为 25.85%:

(1) 本周 (2024.04.15-2024.04.19) 上证综指上涨 1.52%，深证成指上涨 0.56%，沪深 300 指数上涨 1.89%，申万电子板块下跌 2.59%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 21/31。2024 年，电子板块累计下降 16.78%。(2) 品牌消费电子板块在电子行业子板块中涨幅最高，为 2.18%；光学元件板块涨幅最低，为-5.42%。(3) 电子板块涨幅前三公司分别为凯华材料 (+21.43%)、朗特智能 (+21.40%)、沃尔核材 (+16.78%)，跌幅前三公司分别为 ST 宇顺 (-22.73%)、\*ST 碳元 (-22.70%)、ST 恒久 (-22.39%)。(4) PE：截至 2024.04.19，沪深 300 指数 PE 为 11.49 倍，10 年 PE 百分位为 36.54%；SW 电子指数 PE 为 35.11 倍，10 年 PE 百分位为 25.85%。

#### 目 投资建议:

半导体设备建议关注北方华创、中科飞测、精测电子、中微公司、芯基微装等；半导体零部件建议关注旭光电子、富创精密、新莱应材、江丰电子等；AI 产业链建议关注景嘉微、海光信息、沪电股份、胜宏科技等。

#### 目 风险提示:

下游需求不及预期风险；技术迭代不及预期风险；国际科技博弈力度加大风险。

## 目 内容目录

1. 本周新闻一览.....	4
2. 行业数据跟踪.....	5
2.1. 半导体：ASML 24Q1 新增订单不及预期，台积电 24Q1 收入略超指引.....	5
2.2. SiC：纳芯微推出首款 1200V SiC MOSFET，英飞凌与麦田能源达成合作.....	6
2.3. 消费电子：华为 Pura 70 发售，TechInsights 预计全年出货量超 1000 万部....	7
3. 本周行情回顾.....	8
3.1. 涨跌幅：电子排名 21/31，子板块中品牌消费电子涨幅最高.....	8
3.2. PE：电子指数 PE 为 35.11 倍，10 年 PE 百分位为 25.85%.....	9
4. 本周新股.....	11

## 目 图表目录

图 1. 台积电月度营收.....	5
图 2. 世界先进月度营收.....	5
图 3. 联电月度营收.....	5
图 4. 新能源汽车产销量情况.....	6
图 5. 光伏装机情况.....	6
图 6. 国内智能手机月度出货量.....	7
图 7. 国内智能手机月度产量.....	7
图 8. Steam 平台主要 VR 品牌市场份额.....	7
图 9. Steam 平台 VR 月活用户占比.....	7
图 10. 本周各行业板块涨跌幅（申万一级行业分类）.....	8
图 11. 本周电子板块子板块涨跌幅（申万二级行业分类；%）.....	8
图 12. 本周电子板块子板块涨跌幅（申万三级行业分类）.....	8
图 13. 本周电子板块涨幅前十公司（%）.....	9
图 14. 本周电子板块跌幅前十公司（%）.....	9
图 15. 电子板块近十年 PE 走势.....	9
图 16. 电子板块近十年 PE 百分位走势.....	10
图 17. 电子板块子板块近十年 PE 走势.....	10
图 18. 电子板块子板块近十年 PE 百分位走势.....	10
表 1： 本周电子行业新闻一览.....	4
表 2： 本周 IPO 审核状态更新.....	11
表 3： 本周重点 IPO 动态.....	11

## 1. 本周新闻一览

表1：本周电子行业新闻一览

赛道	日期	来源	内容
半导体	4月17日	中国日报	ASML：发布FY24Q1财报，该季度实现了53亿欧元的净销售额，毛利率为51.0%，净利润达到12亿欧元；公司新订单额36亿欧元，其中EUV光刻机订单为6.56亿欧元；中国大陆市场光刻机收入占比环比由39%提升至49%，收入同比增长41%。
	4月18日	公司公告	台积电：发布FY24Q1财报，该季度实现了188.7亿美元收入(YoY+12.9%，QoQ-3.8%)，略超指引(180-188亿美元)上限；毛利率53.1%(YoY-3.2pct，QoQ+0.1pct)。在人工智能应用热潮下，先进芯片的需求仍然强劲。
AI	4月16日	财联社	Adobe：正在计划对其视频编辑软件Premiere Pro引入一系列生成式AI工具，包括自动填充场景中的某些部分或消除干扰等功能，还考虑允许第三方AI工具，如OpenAI的Sora等进入其视频编辑平台。
	4月19日	VR陀螺	Meta：发布了其最新的开源大语言模型Llama 3，该模型提供了80亿和700亿两种参数规模版本，在一些基准测试中超越了市场上类似的大模型，例如谷歌的Gemma和Gemini、Mistral 7B和Anthropic的Claude 3；还推出了搭载此大模型的Meta AI，Meta AI已被集成到Meta旗下的多个产品中，包括Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger等。
	4月19日	集微网	微软：设定了在2024年底前积累180万个AI芯片的目标，并计划将GPU数量增加两倍，以加快生成式AI技术的发展，并在此领域保持领先地位，到2027财年，微软预计将在GPU和数据中心上的投资达到约1000亿美元。
SiC	4月17日	英飞凌官微	英飞凌：将为麦田能源提供CoolSiC™ MOSFET 1200V功率半导体器件，配合EiceDRIVER™栅极驱动用于工业储能应用，凭借SiC可将损耗降低50%，在不增加电池尺寸的情况下，额外提供约2%的能量。
	4月17日	纳芯微官微	纳芯微：推出了其首款1200V SiC MOSFET NPC060N120A系列产品，该产品具备60mΩ的RDSon，提供了通孔式T0-247-4L与表面贴装T0-263-7L两种封装形式，并可选择车规与工规两种等级。这一系列产品设计用于满足电动汽车(EV)OBC/DC-DC、热管理系统、光伏和储能系统(ESS)以及不间断电源(UPS)等应用领域的需求。
汽车电子	4月18日	电动汽车观察家	理想汽车：发布了理想L6，该车型全系搭载了磷酸铁锂电池。理想L6的起始定价由预定的25.98万元下调至24.98万元，而L6 Max的定价为27.98万元，定价策略不仅低于行业预期，还为早期购车者提供了价值2万元的首销权益。
	4月19日	财联社	特斯拉：宣布召回3878辆2024年款Cybertruck电动皮卡，原因是存在油门踏板可能卡住导致意外加速的问题，这增加了发生碰撞的风险。这次召回是特斯拉在2024年第一季度的第三次召回，累计影响了约240万辆汽车。
消费电子	4月17日	财联社	苹果公司：宣布计划在新加坡宏茂桥区扩大其园区和业务，投资额超过2.5亿美元。这一举措是在首席执行官蒂姆·库克访问越南和印尼之后宣布的，随着库克即将到访新加坡，该公司在声明中提到这次扩展将支持人工智能和其他关键职能领域的增长。
	4月18日	TechInsight	华为：发布了新的Pura 70系列智能手机，包括四种型号：Pura 70、Pura 70 Pro、Pura 70 Pro+和Pura 70 Ultra。这次发布的时机和产品推出策略可能使Pura 70系列在2024年的出货量超过1000万部，成为苹果iPhone 15和16系列的主要竞争对手之一。
	4月18日	联想科技创新大会	联想：发布了内置个人智能体“联想小天”的AI PC系列产品，涵盖Yoga、Think及小新系列，价格从5999-17999元不等。
存储	4月16日	集微网	美光公司：232层QLC NAND闪存芯片已在部分国家和地区开始量产并发货，这款芯片搭载在美光子品牌英睿达的企业级固态硬盘上，同时也向OEM制造商提供了样品，这款232层QLC NAND芯片在存储密度和性能上具有行业领先优势，比特密度比主要竞争对手高出28%，I/O速度可达2400MT/s。
	4月19日	全球半导体观察	SK海力士：宣布将与台积电共同开发预计于2026年投产的第六代高带宽存储器(HBM4)，主要聚焦于通过台积电的先进逻辑工艺改善基础裸片的性能，这些裸片在HBM技术中用于控制堆叠的DRAM芯片，将使基础裸片能够集成更多功能，从而提高整体产品的性能和功效。

资料来源：国投证券研究中心整理

## 2. 行业数据跟踪

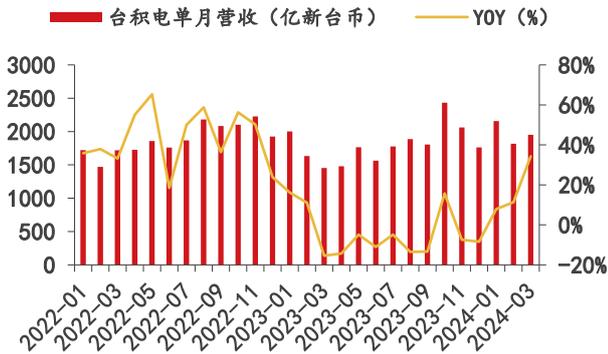
### 2.1. 半导体：ASML 24Q1 新增订单不及预期，台积电 24Q1 收入略超指引

ASML 24Q1 实现收入 52.9 亿欧元 (YoY-21.6%, QoQ-26.9%)，毛利率 51.0%，同环比持平。系统销售收入下降至 39.7 亿欧元 (YoY-25.8%, QoQ-30.2%)，共售出 70 台光刻机 (EUV 11 台)；中国大陆地区收入 19 亿欧元 (YoY+41%, QoQ-14%)，收入占比提升至 49% (QoQ+10pct)。公司一季度新增订单为 36.1 亿欧元，远低于路透社分析师调查预期的 54 亿欧元。公司指引 24Q2 收入 57-62 亿欧元，毛利率 50%-51%，预计全年收入同比持平，2025 年有望强劲增长。

台积电 24Q1 实现收入 188.7 亿美元 (YoY+12.9%, QoQ-3.8%)，略超指引上限；毛利率 53.1% (YoY-3.2pct, QoQ+0.1pct)，位于指引中值。AI 将成为拉动公司 HPC (高性能计算) 需求增长的最强驱动力，24Q1 HPC 收入占比达到 46% (QoQ+3pct)，收入同比增长 21%，环比增长 3%。公司预计 2024 年 AI 服务器处理器收入将至少翻倍增长，收入占比超 10%，未来五年将以 50% 的年复合增速快速增长，2028 年收入占比超 20%。公司下调了 2024 年半导体行业 (不含存储) 增速至 10% 及晶圆代工行业增速至 15-20%。公司预计 24Q2 收入 196-204 亿美元，毛利率 51%-53%，全年收入预计增长 20% 以上，资本支出维持 280-320 亿美元指引。

2024 年 3 月台积电单月营收 1952.1 亿新台币，同比增长 34.25%，环比增长 7.47%。世界先进 2024 年 3 月营收 36.84 亿新台币，同比增长 44.82%，环比增长 17.41%。联电 2024 年 3 月营收 181.67 亿新台币，同比增长 2.70%，环比增长 4.10%。

图1. 台积电月度营收



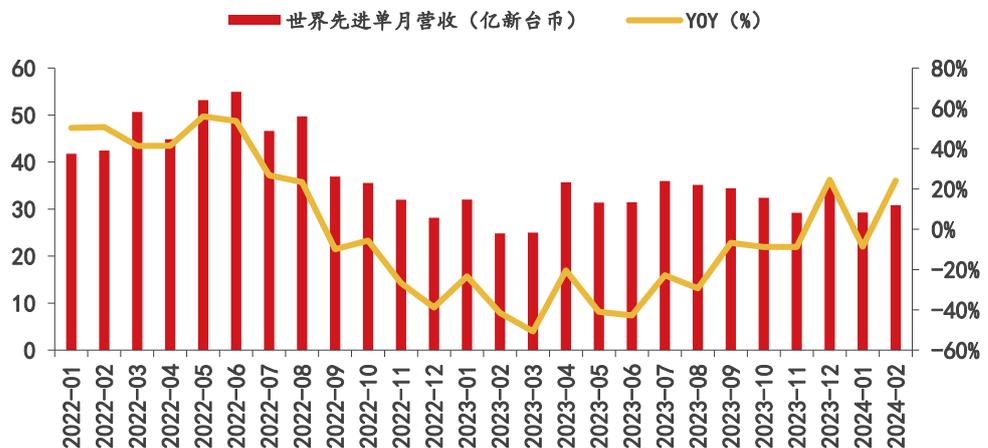
资料来源：台积电公司官网，国投证券研究中心

图2. 世界先进月度营收



资料来源：世界先进公司官网，国投证券研究中心

图3. 联电月度营收



资料来源：联电公司官网，国投证券研究中心

## 2.2. SiC: 纳芯微推出首款 1200V SiC MOSFET, 英飞凌与麦田能源达成合作

纳芯微推出了其首款 1200V SiC MOSFET NPC060N120A 系列产品, 该产品具备 60mΩ 的 RDSon, 提供了通孔式 T0-247-4L 与表面贴装 T0-263-7L 两种封装形式, 并可选择车规与工规两种等级。这一系列产品设计用于满足电动汽车 (EV) OBC/DC-DC、热管理系统、光伏和储能系统 (ESS) 以及不间断电源 (UPS) 等应用领域的需求。纳芯微的 SiC MOSFET 产品具备多种优点, 包括优异的 RDSon 温度稳定性、更宽的门极驱动电压覆盖度以及高可靠性。公司在 SiC 芯片的生产过程中执行了严格的质量控制, 确保每个产品均经过 100% 的静态电参数测试和抗雪崩能力测试。此外, 纳芯微采用的测试条件甚至比 AEC-Q101 标准更加严格, 以验证产品的高可靠性。

英飞凌官方宣布麦田能源的 H3PRO 系列 15kW 到 30kW 的储能机型将全面采用英飞凌的 1200V SiC (碳化硅) 器件。根据这项合作, 英飞凌将为麦田能源提供 CoolSiC™ MOSFET 1200V 功率半导体器件, 这些器件将与 EiceDRIVER™ 栅极驱动器搭配使用, 以优化储能系统的性能。使用 SiC 技术的储能设备可以显著降低能量损失, 据估计损耗可降低 50%, 并且在 not 增加电池尺寸的情况下额外提供约 2% 的能量。这对于需要高性能、轻量化和紧凑设计的储能解决方案来说是一个重要的优势。

由中汽协公布的新能源车产销量数据, 2024 年 3 月, 国内新能源汽车产量由去年 67.40 万辆增长至 86.30 万辆, 销量由去年 65.30 万辆增长至 88.30 万辆。3 月产销量仍保持同比增长, 汽车消费端动能不减。

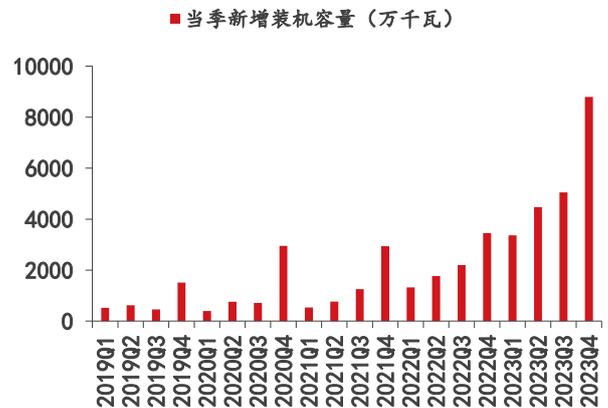
光伏方面, 国内近年来季度光伏安装量增长迅速, 据国家能源局发布的全国电力工业统计数据, 2023Q4 国内光伏新增装机达到 87.94GW, 环比增长 74.07%, 同比增长 154.53%。光伏产业的迅速发展同样能够带动对第三代半导体 (碳化硅) 功率器件的需求。

图4. 新能源汽车产销量情况



资料来源: 中国汽车工业协会, Wind, 国投证券研究中心

图5. 光伏装机情况



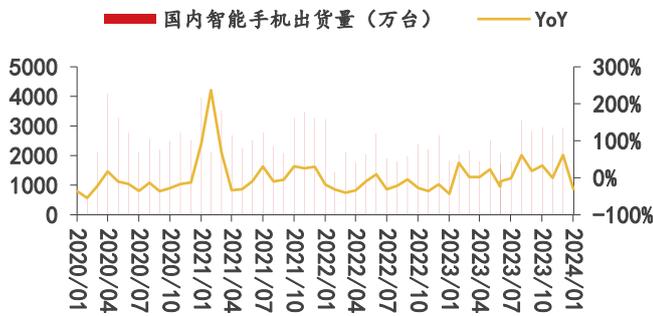
资料来源: 国家能源局, 国投证券研究中心

### 2.3. 消费电子：华为 Pura 70 发售，TechInsights 预计全年出货量超 1000 万部

4月18日，华为推出了新的旗舰智能手机系列——Pura 70，包括四种型号：Pura 70、Pura 70 Pro、Pura 70 Pro+和Pura 70 Ultra。据TechInsights数据，华为Mate 60 Pro系列在2023年的最后五个月内在中国市场出货量达到620万部；Pura 70系列有较早的发布窗口和缓解的供应限制，预计将在2024年出货超过1000万部，成为苹果iPhone 15和16系列的主要竞争对手之一。TechInsights预测，2024年华为在中国的智能手机出货量将超过5000万部，市场份额将从2023年的12%大幅提高到19%，有望重新夺回中国市场的领先地位；尽管Pura 70系列预计今年不会在海外市场上市，但其在中国市场的成功有望帮助华为以5%的全球市场份额成为全球第八大智能手机制造商。

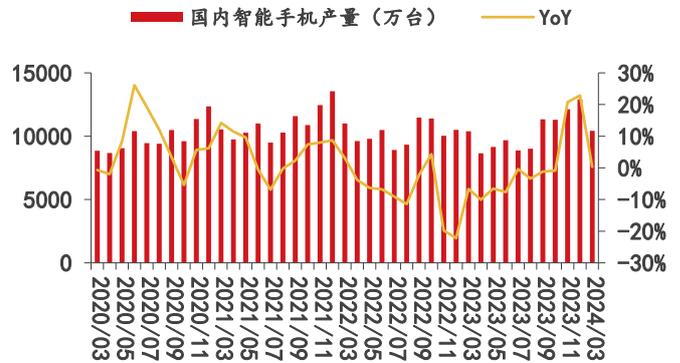
**智能手机：**据中国信通院，2024年2月中国智能手机出货量为1404.2万台(YoY-31.3%，MoM-52.4%)；据国家统计局，2024年3月中国智能手机产量为1.04亿台(YoY+0.4%，MOM-19.3%)。

图6. 国内智能手机月度出货量



资料来源: Wind, 中国信通院, 国投证券研究中心

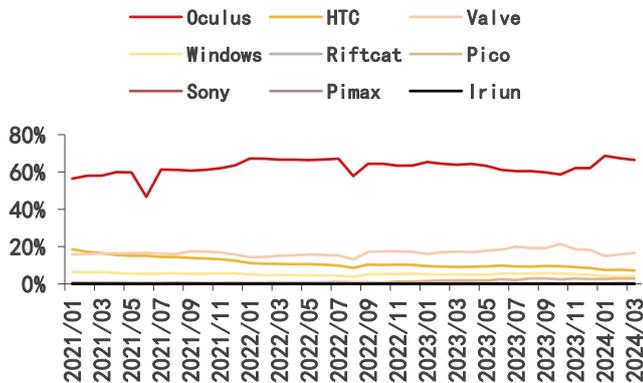
图7. 国内智能手机月度产量



资料来源: Wind, 国家统计局, 国投证券研究中心

**VR：**据Steam，2024年3月Oculus在Steam平台的份额占比为66.49%，YoY+2.59pct，MoM-0.95pct，而Pico份额占比为2.84%，YoY+0.88pct，MoM-0.06pct；Steam平台VR月活用户占比为1.82%，YoY+0.44pct，MoM-0.15pct。

图8. Steam 平台主要 VR 品牌市场份额



资料来源: Steam, 国投证券研究中心

图9. Steam 平台 VR 月活用户占比



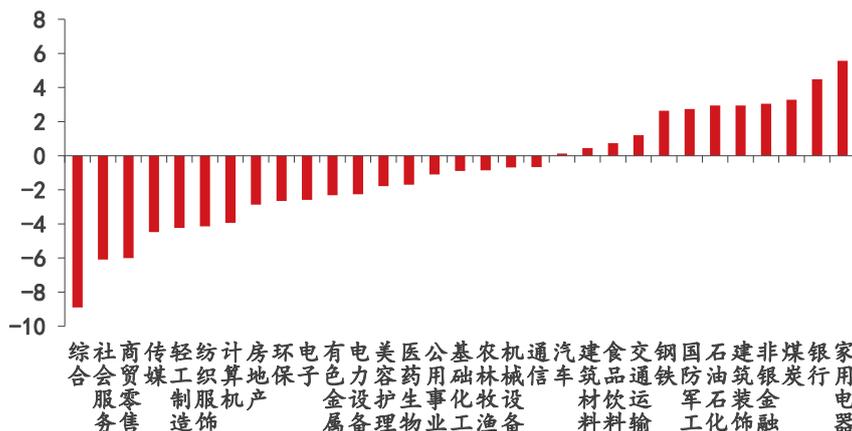
资料来源: Steam, 国投证券研究中心

### 3. 本周行情回顾

#### 3.1. 涨跌幅：电子排名 21/31，子板块中品牌消费电子涨幅最高

- 全行业：本周（2024.04.15-2024.04.19）上证综指上涨 1.52%，深证成指上涨 0.56%，沪深 300 指数上涨 1.89%，申万电子板块下跌 2.59%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 21/31。2024 年，电子板块累计下降 16.78%。

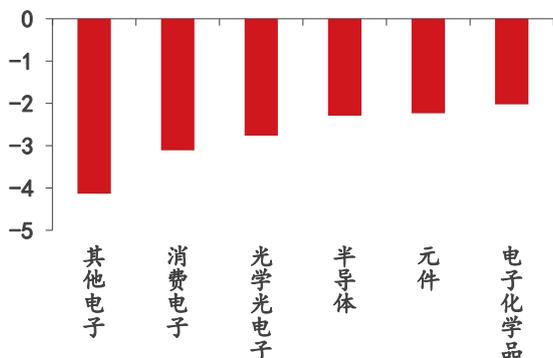
图10. 本周各行业板块涨跌幅（申万一级行业分类）



资料来源：Wind，国投证券研究中心

- 电子行业：本周（2024.04.15-2024.04.19）电子化学品在电子行业子板块中涨幅最高，为-2.02%；其他电子板块涨幅最低，为-4.14%；进一步细分来看，品牌消费电子板块在电子行业子板块中涨幅最高，为 2.18%；光学元件板块涨幅最低，为-5.42%。

图11. 本周电子板块子板块涨跌幅（申万二级行业分类；%）



资料来源：Wind，国投证券研究中心

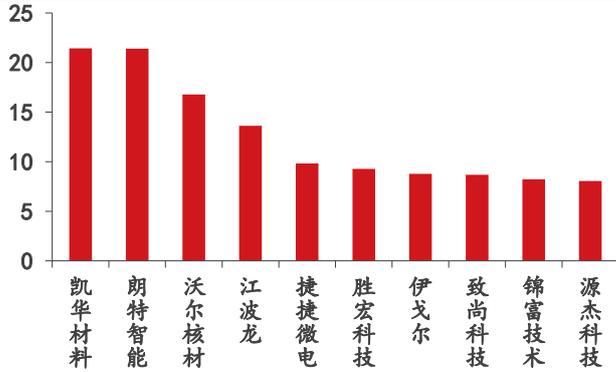
图12. 本周电子板块子板块涨跌幅（申万三级行业分类）

申万二级行业名称	周涨跌幅 (%)	申万三级行业名称	周涨跌幅 (%)
半导体	-2.29	分立器件	-2.18
		半导体材料	-2.29
		数字芯片设计	-2.42
		模拟芯片设计	-4.70
		集成电路封测	-4.97
		半导体设备	-1.09
元件	-2.23	印制电路板	-3.00
		被动元件	-0.58
光学光电子	-2.76	面板	-1.47
		LED	-4.45
		光学元件	-5.42
其他电子	-4.14	其他电子	-4.14
消费电子	-3.11	品牌消费电子	2.18
		消费电子零部件及组装	-3.91
电子化学品	-2.02	电子化学品	-2.02

资料来源：Wind，国投证券研究中心

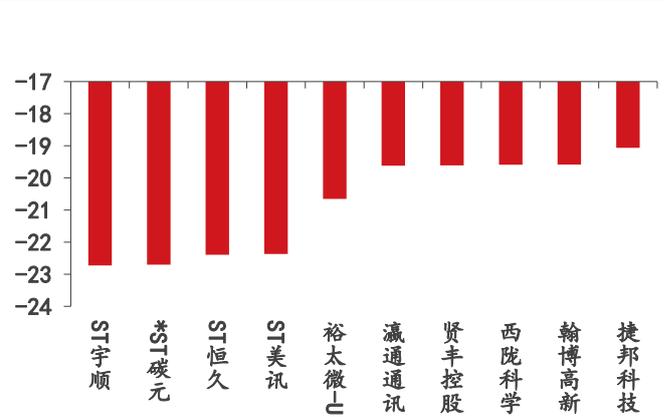
- **电子标的：**本周（2024.04.15-2024.04.19）电子板块涨幅前三公司分别为凯华材料（+21.43%）、朗特智能（+21.40%）、沃尔核材（+16.78%），跌幅前三公司分别为ST宇顺（-22.73%）、\*ST碳元（-22.70%）、ST恒久（-22.39%）。

图13. 本周电子板块涨幅前十公司（%）



资料来源：Wind，国投证券研究中心

图14. 本周电子板块跌幅前十公司（%）

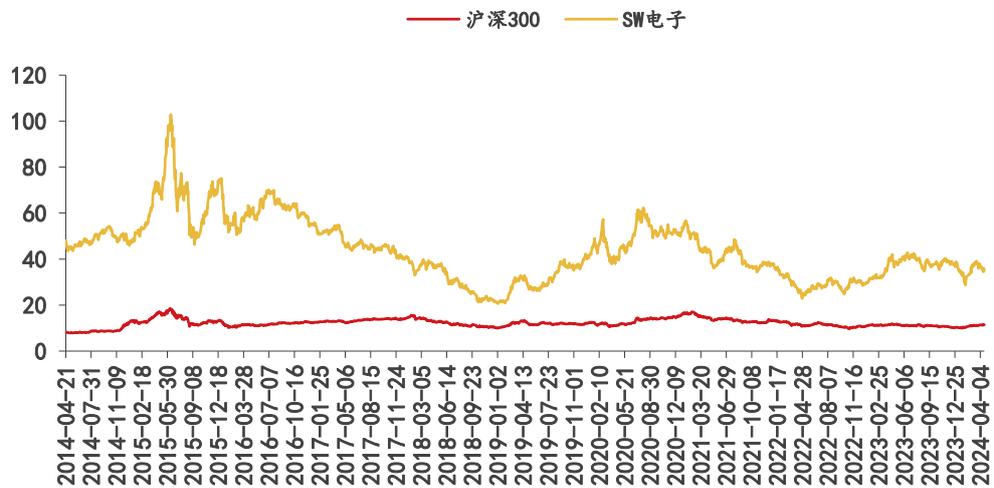


资料来源：Wind，国投证券研究中心

### 3.2. PE：电子指数 PE 为 35.11 倍，10 年 PE 百分位为 25.85%

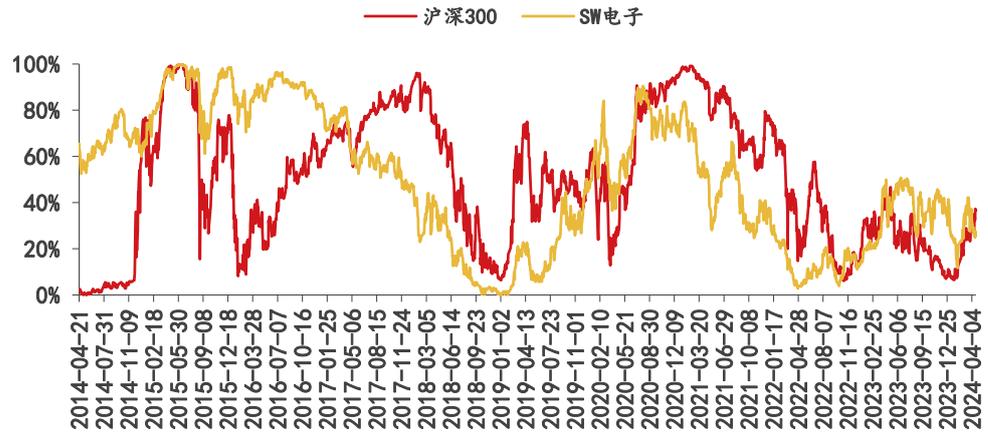
- **电子行业：**截至 2024.04.19，沪深 300 指数 PE 为 11.49 倍，10 年 PE 百分位为 36.54%；SW 电子指数 PE 为 35.11 倍，10 年 PE 百分位为 25.85%。

图15. 电子板块近十年 PE 走势



资料来源：Wind，国投证券研究中心

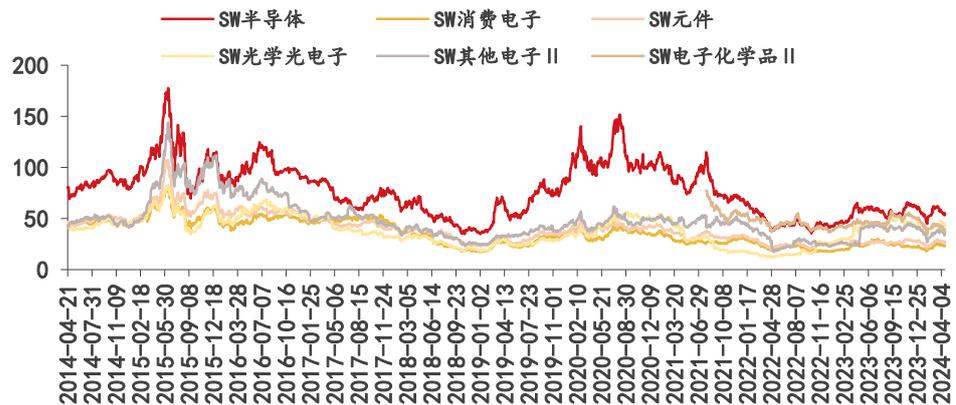
图16. 电子版块近十年 PE 百分位走势



资料来源: Wind, 国投证券研究中心

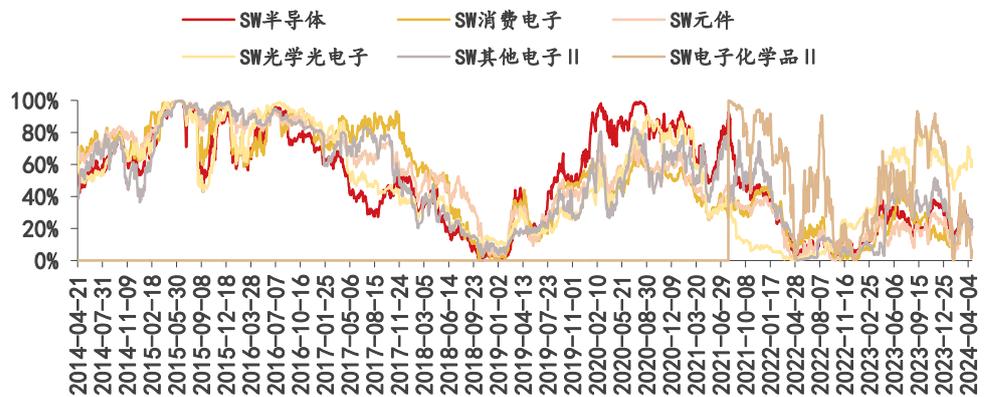
- 电子行业子版块: 截至 2024. 04. 19, 子行业子版块 PE/PE 百分位分别为半导体 (53.84 倍/20.51%)、消费电子 (23.30 倍/20.26%)、元件 (26.82 倍/20.18%)、光学光电子 (43.00 倍/58.78%)、其他电子 (36.20 倍/23.88%)、电子化学品 (38.76 倍/4.71%)。

图17. 电子版块子版块近十年 PE 走势



资料来源: Wind, 国投证券研究中心

图18. 电子版块子版块近十年 PE 百分位走势



资料来源: Wind, 国投证券研究中心

## 4. 本周新股

表2：本周 IPO 审核状态更新

	4.15	4.16	4.17	4.18	4.19
已受理					
已问询				天盛股份	
已回复					
已审核通过					
报送证监会			珂玛科技		
证监会注册				绿联科技	
正在发行					

表3：本周重点 IPO 动态

### 珂玛科技（报送证监会）

#### 公司简介

公司是国内本土先进陶瓷材料及零部件的领先企业之一，掌握关键的材料配方与加工工艺，并具备先进陶瓷前制造、硬脆难加工材料加工和新品表面处理等全工艺流程技术。主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务；目标市场为泛半导体、电子（包括锂电池）材料粉体粉碎和分级、燃料电池制造、化工环保、汽车制造、生物医药以及传统的纺织造纸等领域。目前公司拥有由氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钇和氧化钛 6 大类材料组成的先进陶瓷基础材料体系，主要类型材料的耐腐蚀、电绝缘、高导热、强机械性能等性能已达到国际主流客户的严格标准。依托领先的材料能力和丰富的加工制造工艺，公司的先进陶瓷材料零部件的下游领域覆盖较为广阔。在表面处理方面，公司具备较强的综合服务能力，具备对氧化铝、氮化铝、氧化钇等各基材先进陶瓷材料和金属材料等多种零部件的表面处理能力，且具备精密清洗、阳极氧化和熔射等多种工艺服务能力，并在熔射细分领域具备较强的市场竞争力。

#### 赛道分析

先进陶瓷是在多个国民经济重要领域中发挥着重要作用的关键基础材料。日本在先进陶瓷的产业化和工业、民用领域应用方面占据领先地位，日资企业在全世界先进陶瓷领域占据约 50% 的市场份额，在电子陶瓷、光导纤维、高韧性陶瓷、陶瓷敏感原件、泡沫陶瓷、超塑性陶瓷、塑胶复合陶瓷、高性能陶瓷电池和陶瓷发动机部件等领域均处于国际领先地位。2021 年中国先进陶瓷市场规模达到 890 亿元，约占全球市场的 23%。公司在半导体领域的本土先进结构陶瓷企业中处于市场领先地位。根据弗若斯特沙利文数据，2021 年公司占中国大陆国产半导体设备的先进结构陶瓷采购总规模的约 14%，占中国大陆国产半导体设备的大陆本土先进结构陶瓷供应商供应总规模的约 72%。公司在半导体设备用高纯度氧化铝、高导热氮化铝零部件和分级机用分级轮等“卡脖子”产品方面不同程度上实现了国产替代，填补了中国本土企业在先进陶瓷行业的空白。表面处理行业针对新品制造的表面处理服务需求规模相对较小（仅考虑由设备制造原厂委托专业第三方表面处理服务厂商的部分，不包括设备制造原厂自行实施的部分），仅约占整体市场规模的 5%；对使用后零部件的表面处理约占整体市场规模的 95%，是行业主要需求来源。根据弗若斯特沙利文数据，2021 年公司在大陆显示面板表面处理市场份额约为 6%，其中在显示面板刻蚀细分领域市场份额约 14%。

#### 募投项目

序号	募投金额（万元）	建设期	项目名称
1	35,000.00	3 年	先进材料生产基地项目
2	12,000.00	3 年	泛半导体核心零部件加工制造项目
3	28,000.00	3 年	研发中心建设项目
4	15,000.00		补充流动资金
<b>合计金额</b>	<b>90,000.00</b>		

#### 财务表现

（亿元）	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
营业收入		3.45	4.62	4.80
归母净利润		0.67	0.93	0.82

资料来源：Wind，国投证券研究中心整理

## 目 行业评级体系

收益评级:

领先大市 —— 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10%及以上;

同步大市 —— 未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%;

落后大市 —— 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%及以上;

风险评级:

A —— 正常风险, 未来 6 个月的投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动;

B —— 较高风险, 未来 6 个月的投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动;

## 目 分析师声明

本报告署名分析师声明, 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责, 保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据, 特此声明。

## 目 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

国投证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会核准, 取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告, 是证券投资咨询业务的一种基本形式, 本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析, 形成证券估值、投资评级等投资分析意见, 制作证券研究报告, 并向本公司的客户发布。

## 目 免责声明

本报告仅供国投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准，如有需要，客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国投证券股份有限公司研究中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设，并采用适当的估值方法和模型得出的，由于假设、估值方法和模型均存在一定的局限性，估值结果和分析结论也存在局限性，请谨慎使用。

国投证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

### 国投证券研究中心

深圳市

地 址： 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 33 楼

邮 编： 518026

上海市

地 址： 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 3 层

邮 编： 200080

北京市

地 址： 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 15 层

邮 编： 100034